



2023年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕（連結）

2022年11月14日

上場取引所 東

上場会社名 株式会社フェローテックホールディングス
 コード番号 6890 URL <http://www.ferrotec.co.jp>
 代表者 (役職名) 代表取締役社長 (氏名) 賀 賢漢
 問合せ先責任者 (役職名) 代表取締役副社長 (氏名) 山村 丈 TEL 03-3281-8186
 四半期報告書提出予定日 2022年11月14日 配当支払開始予定日 2022年12月12日
 四半期決算補足説明資料作成の有無 : 有
 四半期決算説明会開催の有無 : 有 (機関投資家・アナリスト向け)

(百万円未満切捨)

1. 2023年3月期第2四半期の連結業績（2022年4月1日～2022年9月30日）

(1) 連結経営成績（累計）

(%表示は、対前年同四半期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		親会社株主に帰属する 四半期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
2023年3月期第2四半期	97,505	63.0	17,061	59.3	23,554	88.9	15,979	△7.4
2022年3月期第2四半期	59,826	43.8	10,708	173.7	12,468	341.4	17,257	—

(注) 包括利益 2023年3月期第2四半期 40,148百万円 (76.0%) 2022年3月期第2四半期 22,808百万円 (—%)

	1株当たり 四半期純利益	潜在株式調整後 1株当たり 四半期純利益
	円 銭	円 銭
2023年3月期第2四半期	352.88	340.76
2022年3月期第2四半期	460.26	417.62

(注) 2022年3月期第3四半期連結会計期間において、企業結合に係る暫定的な会計処理の確定を行っており、2022年3月期第2四半期に係る各数値について、暫定的な会計処理の確定の内容を反映させております。

(2) 連結財政状態

	総資産	純資産	自己資本比率	1株当たり純資産
	百万円	百万円	%	円 銭
2023年3月期第2四半期	370,333	225,026	47.3	3,742.56
2022年3月期	264,772	160,957	49.5	2,940.93

(参考) 自己資本 2023年3月期第2四半期 175,331百万円 2022年3月期 131,022百万円

2. 配当の状況

	年間配当金				
	第1四半期末	第2四半期末	第3四半期末	期末	合計
	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭
2022年3月期	—	23.00	—	27.00	50.00
2023年3月期	—	50.00	—	—	—
2023年3月期（予想）	—	—	—	50.00	100.00

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 : 有

2022年3月期第2四半期末配当金の内訳 普通配当 14円00銭 特別配当 9円00銭
 2022年3月期期末配当金の内訳 普通配当 18円00銭 特別配当 9円00銭

3. 2023年3月期の連結業績予想（2022年4月1日～2023年3月31日）

（％表示は、対前期増減率）

	売上高		営業利益		経常利益		親会社株主に帰属する当期純利益		1株当たり 当期純利益
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%	円 銭
通期	200,000	49.5	34,000	50.4	39,000	50.0	24,000	△10.0	521.01

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無：有

※ 注記事項

（1）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）：無
新規 一社（社名）一、除外 一社（社名）一

（2）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用：有

（注）詳細は、添付資料10ページ「2. 四半期連結財務諸表及び主な注記（4）四半期連結財務諸表に関する注記事項（四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用）」をご覧ください。

（3）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

- ① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更：有
- ② ①以外の会計方針の変更：無
- ③ 会計上の見積りの変更：無
- ④ 修正再表示：無

（4）発行済株式数（普通株式）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む）	2023年3月期2Q	46,942,367株	2022年3月期	44,645,431株
② 期末自己株式数	2023年3月期2Q	94,233株	2022年3月期	93,897株
③ 期中平均株式数（四半期累計）	2023年3月期2Q	45,282,920株	2022年3月期2Q	37,494,517株

※ 四半期決算短信は公認会計士又は監査法人の四半期レビューの対象外です

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、その達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、添付資料3ページ「1. 当四半期決算に関する定性的情報（3）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明」をご覧ください。

決算説明会（機関投資家・アナリスト向け）は、2022年12月2日に質疑応答を主目的としたオンライン（WEB）での開催を予定しております。

決算説明資料については、2022年12月1日に当社ホームページに掲載する予定です。

○添付資料の目次

1. 当四半期決算に関する定性的情報	2
(1) 経営成績に関する説明	2
(2) 財政状態に関する説明	3
(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明	3
2. 四半期連結財務諸表及び主な注記	4
(1) 四半期連結貸借対照表	4
(2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書	6
四半期連結損益計算書	
第2四半期連結累計期間	6
四半期連結包括利益計算書	
第2四半期連結累計期間	7
(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書	8
(4) 四半期連結財務諸表に関する注記事項	10
(継続企業の前提に関する注記)	10
(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)	10
(四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用)	10
(会計方針の変更)	10
(セグメント情報等)	11

1. 当四半期決算に関する定性的情報

(1) 経営成績に関する説明

当第2四半期連結累計期間における経営環境については、欧米諸国を中心に新型コロナウイルスまん延防止から正常化への動きが本格化するなか、インフレ抑制のための政策金利引き上げが続きました。日本は夏に新型コロナの感染者が急増したのち、9月以降減少傾向となり、外国人の入国規制緩和が発表されるなど正常化の方向に進んでおります。一方、中国ではゼロコロナ政策による社会統制を継続しており、経済活動への影響が懸念されております。また、ロシアのウクライナ侵攻は継続しており、燃料や資材価格に影響を与えております。

為替相場は、更に円安方向に進みました。

当社グループの属するエレクトロニクス産業では、リモートワークやWEB会議の普及もあり、データセンターや通信向けの需要は高水準で推移しております。半導体製造装置の需要も高水準に推移しましたが、メモリなど一部製品で在庫余りなどの調整の兆しが見られ始めました。

このような事業環境のなか、当社グループの半導体等装置関連事業では、製造装置向けの真空部品や半導体製造プロセスに使用される各種マテリアル製品（石英製品・セラミックス製品・シリコンパーツ等）など各製品で販売を大きく伸ばしました。

電子デバイス事業では、主力のサーモモジュールで通信機器向けや半導体装置向けを中心に需要は堅調に推移しました。パワー半導体用基板は、中国でのEV（電気自動車）向け販売が軌道に乗り、成長を後押ししました。

なお、経常利益は為替差益が51億円発生し、前年同期比で大きく増加しました。一方、前年同期は持分法適用会社の第三者割当増資に伴う93億円の持分変動利益（特別利益）を計上したため、相対的に当第2四半期連結累計期間は特別利益が減少しております。

この結果、当第2四半期連結累計期間の経営成績は、売上高は97,505百万円（前年同期比63.0%増）、営業利益は17,061百万円（前年同期比59.3%増）、経常利益は23,554百万円（前年同期比88.9%増）となり、親会社株主に帰属する四半期純利益は15,979百万円（前年同期比7.4%減）となりました。

当第2四半期連結累計期間のセグメントの経営成績は、次のとおりであります。

なお、第1四半期連結会計期間より報告セグメントの区分を変更しております。以下の前年同期比較については、変更後のセグメント区分に組み替えた数値で比較しております。詳細は、「2. 四半期連結財務諸表及び主な注記 (4) 四半期連結財務諸表に関する注記事項 (セグメント情報等)」に記載しております。

(半導体等装置関連事業)

当該事業の主な製品は、真空シール及び各種製造装置向け金属加工製品、石英製品、セラミックス製品、CVD-SiC製品、シリコンパーツ、装置部品洗浄、石英坩堝などです。

昨今のコロナ禍をきっかけに、リモートワークやWEB会議が定着するなどWEB通信量が増大傾向にあるなか、データセンターや通信向けの需要は高水準で推移しました。半導体関連の増産投資による製造装置の需要も堅調であり、当社の真空シールおよび各種製造装置向け金属加工製品は各製造装置向けに大きく売上を伸ばしました。

半導体製造プロセスに使用されるマテリアル製品（石英製品・セラミックス製品・シリコンパーツ等）は、高水準な設備投資と設備稼働率の恩恵を受け売上を大きく伸ばしました。半導体ウエーハや太陽電池製造などで使用される石英坩堝も順調に売上を伸ばしました。

この結果、当該事業の売上高は63,791百万円（前年同期比62.8%増）、営業利益は11,707百万円（前年同期比64.5%増）となりました。

(電子デバイス事業)

当該事業の主な製品は、サーモモジュール、パワー半導体用基板、磁性流体、センサなどです。

主力のサーモモジュールは、5G用の移動通信システム機器向けや半導体分野向け、医療分野向けなどで販売を伸ばしました。

パワー半導体用基板は、AMB基板が中国のEV車載向け出荷が軌道に乗り売上を大きく伸ばすことができました。広範な用途に使用されるDCB基板の販売もIGBT向けを中心に好調を維持し、全体でも大きく売上を伸ばしました。

また、当第2四半期連結会計期間より連結化したセンサの売上、利益が新たに加わりました。

この結果、当該事業の売上高は23,073百万円（前年同期比88.9%増）、営業利益は5,325百万円（前年同期比74.5%増）となりました。

(その他)

「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、ソーブレード、工作機械、太陽電池用シリコン製品等の事業を含んでおります。

当該事業の売上高は10,640百万円（前年同期比26.2%増）、営業利益は398百万円（前年同期比39.7%減）となりました。

(2) 財政状態に関する説明

<資産>

当第2四半期連結会計期間末の資産は、前連結会計年度末と比べ105,561百万円増加し、370,333百万円となりました。これは主に現金及び預金31,246百万円、受取手形、売掛金及び契約資産16,482百万円、有形固定資産38,533百万円の増加によるものであります。

<負債>

当第2四半期連結会計期間末の負債は、前連結会計年度末と比べ41,491百万円増加し、145,306百万円となりました。これは主に転換社債型新株予約権付社債2,134百万円の減少があった一方、支払手形及び買掛金7,388百万円、短期借入金7,325百万円、長期借入金（1年内返済予定を含む）15,338百万円の増加によるものであります。

<純資産>

当第2四半期連結会計期間末の純資産は、前連結会計年度末と比べ64,069百万円増加し、225,026百万円となりました。これは主に利益剰余金14,958百万円、為替換算調整勘定17,334百万円、非支配株主持分19,762百万円の増加によるものであります。

(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

連結業績予想につきましては、2022年8月12日の「連結業績予想の修正に関するお知らせ」で公表いたしました業績予想を修正しております。

なお、詳細につきましては、本日公表いたしました「2023年3月期第2四半期（累計）の連結業績予想と実績値の差異および通期の連結業績予想の修正並びに配当予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。

2. 四半期連結財務諸表及び主な注記

(1) 四半期連結貸借対照表

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (2022年3月31日)	当第2四半期連結会計期間 (2022年9月30日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	52,579	83,825
受取手形、売掛金及び契約資産	41,797	58,279
商品及び製品	7,858	10,246
仕掛品	7,882	11,963
原材料及び貯蔵品	12,696	20,346
その他	11,110	6,898
貸倒引当金	△509	△618
流動資産合計	133,414	190,942
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物（純額）	22,728	30,782
機械装置及び運搬具（純額）	25,122	34,599
工具、器具及び備品（純額）	5,324	6,295
土地	1,895	4,160
リース資産（純額）	4,040	9,269
建設仮勘定	24,972	37,508
有形固定資産合計	84,083	122,616
無形固定資産		
のれん	283	3,427
その他	1,713	2,424
無形固定資産合計	1,996	5,852
投資その他の資産		
関係会社株式	36,058	36,314
その他	9,842	15,305
貸倒引当金	△623	△699
投資その他の資産合計	45,277	50,921
固定資産合計	131,358	179,390
資産合計	264,772	370,333

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (2022年3月31日)	当第2四半期連結会計期間 (2022年9月30日)
負債の部		
流動負債		
支払手形及び買掛金	26,702	34,091
電子記録債務	4,068	3,652
短期借入金	6,324	13,650
1年内償還予定の社債	2,658	4,948
1年内返済予定の長期借入金	5,843	8,331
未払法人税等	2,207	3,719
賞与引当金	1,556	2,844
その他	19,437	23,924
流動負債合計	68,800	95,160
固定負債		
社債	8,806	5,082
転換社債型新株予約権付社債	2,134	—
長期借入金	11,796	24,647
退職給付に係る負債	560	2,107
資産除去債務	213	298
その他	11,503	18,010
固定負債合計	35,014	50,145
負債合計	103,814	145,306
純資産の部		
株主資本		
資本金	28,210	29,329
資本剰余金	46,071	57,105
利益剰余金	43,317	58,276
自己株式	△87	△88
株主資本合計	117,511	144,623
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	406	249
為替換算調整勘定	13,128	30,462
退職給付に係る調整累計額	△23	△3
その他の包括利益累計額合計	13,511	30,708
新株予約権	45	43
非支配株主持分	29,888	49,651
純資産合計	160,957	225,026
負債純資産合計	264,772	370,333

(2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書

(四半期連結損益計算書)

(第2四半期連結累計期間)

(単位：百万円)

	前第2四半期連結累計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年9月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年9月30日)
売上高	59,826	97,505
売上原価	37,587	62,967
売上総利益	22,238	34,538
販売費及び一般管理費	11,530	17,476
営業利益	10,708	17,061
営業外収益		
受取利息	134	444
補助金収入	347	1,375
為替差益	1,503	5,198
その他	297	362
営業外収益合計	2,283	7,380
営業外費用		
支払利息	349	435
持分法による投資損失	14	249
その他	159	202
営業外費用合計	523	888
経常利益	12,468	23,554
特別利益		
固定資産売却益	12	—
持分変動利益	9,327	618
段階取得に係る差益	—	204
特別利益合計	9,339	822
特別損失		
固定資産処分損	109	65
事業撤退損	927	—
段階取得に係る差損	—	702
その他	126	—
特別損失合計	1,162	768
税金等調整前四半期純利益	20,645	23,608
法人税等	3,043	5,639
四半期純利益	17,602	17,968
非支配株主に帰属する四半期純利益	345	1,989
親会社株主に帰属する四半期純利益	17,257	15,979

(四半期連結包括利益計算書)
(第2四半期連結累計期間)

(単位：百万円)

	前第2四半期連結累計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年9月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年9月30日)
四半期純利益	17,602	17,968
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	174	△153
為替換算調整勘定	3,609	18,043
退職給付に係る調整額	9	71
持分法適用会社に対する持分相当額	1,411	4,218
その他の包括利益合計	5,205	22,179
四半期包括利益	22,808	40,148
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	21,471	33,176
非支配株主に係る四半期包括利益	1,336	6,972

(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：百万円)

	前第2四半期連結累計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年9月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー		
税金等調整前四半期純利益	20,645	23,608
減価償却費	3,820	5,596
のれん償却額	33	100
株式報酬費用	167	205
賞与引当金の増減額 (△は減少)	168	880
役員退職慰労引当金の増減額 (△は減少)	△18	—
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	21	20
退職給付に係る負債の増減額 (△は減少)	0	114
受取利息及び受取配当金	△139	△454
支払利息	349	435
為替差損益 (△は益)	△1,199	△2,000
持分法による投資損益 (△は益)	14	249
段階取得に係る差損益 (△は益)	—	498
固定資産処分損益 (△は益)	96	65
持分変動損益 (△は益)	△9,327	△618
売上債権の増減額 (△は増加)	△2,737	△3,288
棚卸資産の増減額 (△は増加)	△3,523	△5,091
仕入債務の増減額 (△は減少)	1,800	△2,271
その他	△1,598	6,258
小計	8,574	24,310
利息及び配当金の受取額	172	496
利息の支払額	△342	△362
法人税等の支払額	△2,034	△3,456
営業活動によるキャッシュ・フロー	6,369	20,988
投資活動によるキャッシュ・フロー		
有形固定資産の取得による支出	△13,814	△24,852
有形固定資産の売却による収入	351	168
無形固定資産の取得による支出	△84	△76
無形固定資産の売却による収入	18	—
投資有価証券の取得による支出	△201	△4,077
関係会社株式の取得による支出	—	△800
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入	—	848
貸付金の回収による収入	5,517	3
その他	△14	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△8,226	△28,783

(単位：百万円)

	前第2四半期連結累計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年9月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年9月30日)
財務活動によるキャッシュ・フロー		
短期借入金の純増減額 (△は減少)	114	4,170
長期借入れによる収入	1,707	14,366
長期借入金の返済による支出	△3,666	△3,717
リース債務の返済による支出	△68	△228
社債の償還による支出	△1,434	△1,434
株式の発行による収入	84	—
非支配株主からの払込みによる収入	22,181	20,515
自己株式の取得による支出	△0	△0
配当金の支払額	△667	△1,195
非支配株主への配当金の支払額	△18	—
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	—	△9
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入	43	—
その他	—	△4
財務活動によるキャッシュ・フロー	18,274	32,461
現金及び現金同等物に係る換算差額	1,588	6,525
現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	18,007	31,192
現金及び現金同等物の期首残高	30,202	52,579
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	—	△0
現金及び現金同等物の四半期末残高	48,210	83,770

(4) 四半期連結財務諸表に関する注記事項

(継続企業の前提に関する注記)

該当事項はありません。

(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)

当第2四半期連結累計期間において、連結子会社である江蘇富樂華半導体科技股份有限公司及び寧夏盾源聚芯半導体科技股份有限公司が第三者割当増資を実施したため、資本剰余金が9,939百万円増加しました。

また、転換社債型新株予約権付社債の転換に伴い、資本金が1,067百万円、資本剰余金が1,067百万円それぞれ増加しました。

この結果、当第2四半期連結会計期間末において資本金が29,329百万円、資本剰余金が57,105百万円となっております。

(四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用)

(税金費用の計算)

税金費用については、当第2四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。また、見積実効税率を使用できない場合は、税引前四半期純利益に一時差異に該当しない重要な差異を加減した上で、法定実効税率を乗じて計算しております。

なお、法人税等調整額は、法人税等を含めて表示しております。

(会計方針の変更)

(時価の算定に関する会計基準の適用指針の適用)

「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2021年6月17日。以下「時価算定会計基準適用指針」という。)を第1四半期連結会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準適用指針第27-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準適用指針が定める新たな会計方針を将来にわたって適用することといたしました。これによる、四半期連結財務諸表に与える影響はありません。

(セグメント情報等)

【セグメント情報】

I 前第2四半期連結累計期間(自2021年4月1日至2021年9月30日)

1. 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

(単位:百万円)

	報告セグメント			その他 (注1)	合計	調整額 (注2)	四半期連結 損益計算書 計上額 (注3)
	半導体等 装置関連事業	電子デバ イス事業	計				
売上高							
(1)外部顧客への 売上高	39,178	12,213	51,391	8,434	59,826	—	59,826
(2)セグメント間 の内部売上高 又は振替高	—	—	—	—	—	—	—
計	39,178	12,213	51,391	8,434	59,826	—	59,826
セグメント利益	7,118	3,052	10,171	660	10,832	△123	10,708

(注) 1 「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、ソーブレード、工作機械、表面処理、太陽電池用シリコン製品等の事業を含んでおります。

2 セグメント利益の調整額△123百万円には、セグメント間取引の消去△32百万円、各報告セグメントに配分していない全社費用156百万円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

3 セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

2. 報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

(固定資産に係る重要な減損損失)

「半導体等装置関連事業」セグメントにおいて、減損損失256百万円を計上しており、特別損失の事業撤退損に含めて表示しております。

II 当第2四半期連結累計期間(自2022年4月1日至2022年9月30日)

1. 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

(単位:百万円)

	報告セグメント			その他 (注1)	合計	調整額 (注2)	四半期連結 損益計算書 計上額 (注3)
	半導体等 装置関連事業	電子デバ イス事業	計				
売上高							
(1)外部顧客への 売上高	63,791	23,073	86,865	10,640	97,505	—	97,505
(2)セグメント間 の内部売上高 又は振替高	—	—	—	—	—	—	—
計	63,791	23,073	86,865	10,640	97,505	—	97,505
セグメント利益	11,707	5,325	17,033	398	17,431	△369	17,061

- (注) 1 「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、ソーブレード、工作機械、表面処理、太陽電池用シリコン製品等の事業を含んでおります。
- 2 セグメント利益の調整額△369百万円には、セグメント間取引の消去△140百万円、各報告セグメントに配分していない全社費用509百万円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。
- 3 セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

2. 報告セグメントの変更等に関する事項

第1四半期連結会計期間より、従来「その他」に含めていた米国子会社における受託製造事業及び成膜装置事業は、経営管理区分の見直しにより「半導体等装置関連事業」の区分に含めて記載する方法に変更しております。

なお、前第2四半期連結累計期間のセグメント情報については、変更後の区分により作成したものを記載しております。

3. 報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

(のれんの金額の重要な変動)

「電子デバイス事業」セグメントにおいて、株式会社大泉製作所の株式を追加取得に伴い、当第2四半期連結会計期間より連結の範囲に含めております。当該事象によるのれんの増加額は3,010百万円であります。

「その他」セグメントにおいて、東洋刃物株式会社の株式を追加取得に伴い、当第2四半期連結会計期間より連結の範囲に含めております。当該事象によるのれんの増加額は212百万円であります。